

## 低温焼結銅微粒子

# MD-200S (粉体) MDP-200 (ペースト状高濃度分散体)

窒素雰囲気中の処理で、金属銅にほぼ匹敵する導電性能及び、無加圧条件下で実用的な接合強度を発現します。

- ・低温焼結性 … 200℃以下の低温で使用可能
- ・高導電性 … バルクの銅に匹敵する体積抵抗率
- ・高接合強度 … 不活性雰囲気は無加圧接合



MD-200S



MDP-200

### ★性能評価

#### MDP-200組成

銅濃度: 90wt%以上

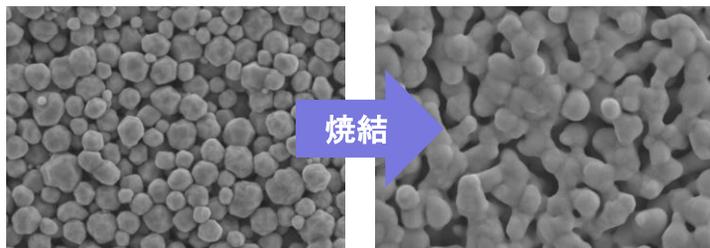
溶媒+添加剤: 10wt%以下

#### 導電性能

##### ・焼成条件

雰囲気: 窒素気流下

温度: 100~200℃



MD-200Sの焼結イメージ

	100℃	150℃	200℃
体積抵抗率 ( $\mu\Omega\cdot\text{cm}$ )	< 300	< 25	< 15

#### 接合性能

##### ・焼成条件

雰囲気: 窒素気流下

温度: 150~200℃

##### ・圧力条件

無加圧



試験片

	150℃	200℃
せん断強度 (MPa)	> 25	> 50

※ JEITA ED-4703 K-111に準拠



石原産業株式会社